

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2016-001

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票募集资金投资项目试生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”日前安装调试完毕，并连续48小时投料试生产成功。经公司检测，产品主要性能指标合格，达到国外同类产品先进水平，CTE指标达到国际领先水平。

“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”投产后，将进一步提升公司行业内领先地位，增强公司整体竞争能力。

公司该项目从试生产到客户认证、销售尚需一段时间，请投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2016年2月23日